

2021-2027年中国半导体用 环氧塑封料行业发展态势与投资前景分析报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2021-2027年中国半导体用环氧塑封料行业发展态势与投资前景分析报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202105/220964.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2021-2027年中国半导体用环氧塑封料行业发展态势与投资前景分析报告》共八章。首先介绍了半导体用环氧塑封料行业市场发展环境、半导体用环氧塑封料整体运行态势等，接着分析了半导体用环氧塑封料行业市场运行的现状，然后介绍了半导体用环氧塑封料市场竞争格局。随后，报告对半导体用环氧塑封料做了重点企业经营状况分析，最后分析了半导体用环氧塑封料行业发展趋势与投资预测。您若想对半导体用环氧塑封料产业有个系统的了解或者想投资半导体用环氧塑封料行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章环氧塑封料产品概述

1.1环氧塑封料产品定义

1.2环氧塑封料的发展历程与产业现状

1.3环氧塑封料技术发展趋势

1.4环氧塑封料在半导体产业中的重要地位

第二章环氧塑封料的组成、品种分类及生产过程

2.1环氧塑封料产品组成

2.2环氧塑封料产品品种分类

2.2.1按其主要组成

2.2.2按其专业用途

2.2.3按其施工条件

2.2.4按其包装形态

2.3环氧塑封料制作过程

2.4环氧塑封料产品性能

2.4.1未固化物理性能

2.4.2固化物理性能

2.4.3机械性能

第三章环氧塑封料的应用及其主要市场领域

3.1ic封装的塑封成形工艺过程

3.1.1ic封装塑封成形的工艺过程

3.1.2ic封装塑封成形的工艺要点

3.1.3ic封装塑封成形的质量保证

3.2环氧塑封料的应用领域

第四章全球半导体封测产业概况及市场分析

4.1世界半导体封装业发展特点

4.2世界半导体封装产品的主要生产制造商

4.3世界半导体封装业的发展现状

4.3.12019年世界半导体产业与市场概况

4.3.2世界封测产业与市场概况

4.4世界封测产业的发展总趋势

4.5世界封测生产值统计

第五章我国半导体封测产业概况及市场分析

5.12019年我国半导体产业发展状况

5.2我国集成电路封测业发展现状

5.2.1我国集成电路产业发展

5.2.2我国集成电路封测产业发展现状

5.2.2.1我国ic封测产业市场规模现状

5.2.2.2我国ic封测厂家分布及产能

5.2.2.3我国ic封测业的骨干生产企业情况

5.2.2.4我国ic封测业内资企业在近期的技术发展

5.3我国半导体分立器件封测业发展现状

5.3.1我国半导体分立器件生产现状

5.3.2我国半导体分立器件行业发展特点

5.3.3我国半导体分立器件产业地区分布及市场结构

5.3.4我国半导体分立器件生产厂家情况

5.3.5我国半导体分立器件市场发展前景

第六章世界环氧塑封料产业的生产与技术现状

- 6.1世界环氧塑封料生产与市场总况
- 6.2世界环氧塑封料主要生产企业概述
- 6.3日本环氧塑封料生产厂家现状
 - 6.3.1住友电木 (sumitomobakelite)
 - 6.3.2日东电工 (nittodenko)
 - 6.3.3日立化成 (hitachichemical)
 - 6.3.4松下电工株式会社 (matsushitaelectric)
 - 6.3.5信越化学工业 (shin-etsuchemical)
 - 6.3.6京瓷化学 (kyocerachemical)
- 6.4台湾长春人造树脂现状
- 6.5韩国环氧塑封料生产厂家现状
 - 6.5.1三星SDI
 - 6.5.2韩国kcc
- 6.6汉高集团 (hysol) 塑封料生产现状

第七章我国环氧塑封料产业现状及国内市场需求

- 7.1我国环氧塑封料业的发展现状
- 7.2我国环氧塑封料业生产情况
- 7.3我国环氧塑封料业技术水平现状
 - 7.3.1环氧塑封料的工艺选择
 - 7.3.2塑封料性能对器件可靠性的影响
- 7.4我国国内环氧塑封料的市场需求情况
- 7.5未来几年我国环氧塑封料行业的市场发展趋势预测
- 7.6我国环氧塑封料的主要生产厂家情况
 - 7.6.1汉高华威电子有限公司
 - 7.6.2长兴电子材料(昆山)有限公司
 - 7.6.3南通住友电木有限公司
 - 7.6.4日立化成工业(苏州)有限公司
 - 7.6.5北京科化新材料科技有限公司
 - 7.6.6佛山市亿通电子有限公司

- 7.6.7浙江恒耀电子材料有限公司
- 7.6.8江苏中鹏电子有限公司
- 7.6.9广州市华塑电子有限公司
- 7.6.10松下电工（上海）电子材料有限公司
- 7.6.11北京中新泰合电子材料科技有限公司
- 7.6.12长春封塑料（常熟）有限公司
- 7.6.13无锡创达电子有限公司
- 7.6.14广东榕泰实业股份有限公司

第八章环氧塑封料生产主要原材料及其需求

8.1emc用环氧树脂

8.1.1emc对环氧树脂原料的要求

8.1.2世界及我国环氧树脂业发展现状

8.1.3国内环氧树脂产业的原材料供应情况

8.1.3.1双酚a

8.1.3.2环氧氯丙烷（ech）

8.1.4绿色化塑封料中的环氧树脂开发情况

8.2emc用硅微粉

8.2.1emc对硅微粉原料的要求

8.2.2emc用硅微粉产品概述

8.2.3国外emc用硅微粉产品生产的现况

8.2.3.1日本emc用硅微粉的生产现况

8.2.3.2北美emc用硅微粉的生产现况

8.2.3.3欧洲emc用硅微粉的生产现况

8.2.4国内emc用硅微粉产品生产的现况

部分图表目录

图表：2019年半导体产业资本支出额企业占比

图表：2019年部分封测企业收入（仅包含纯代工封装企业）

图表：集成电路产业结构

图表：2012-2019年全球半导体设备销售收入

图表：2012-2019年中国半导体设备销售占比

图表：2011-2019年中国ic封测产业销售规模
图表：2011-2019年中国半导体分立器件行业产量
图表：2011-2019年中国半导体分立器件市场规模
图表：我国半导体分立器件生产厂家
图表：2012-2019年4季度全球环氧塑封料行业产量
图表：2012-2019年4季度全球环氧塑封料行业市场规模
图表：2019年住友电木环氧塑封料产量对比
图表：2019年日东电工环氧塑封料产量对比
图表：2019年日立化成环氧塑封料产量对比
图表：2019年松下电工株式会社环氧塑封料产量对比
图表：2019年信越化学工业环氧塑封料产量对比
图表：2019年京瓷化学环氧塑封料产量对比
图表：2019年长春人造树脂环氧塑封料产量对比
图表：2019年三星SDI环氧塑封料产量对比
图表：2019年韩国kcc环氧塑封料产量对比
图表：2019年汉高集团环氧塑封料产量对比
图表：2012-2019年4季度中国环氧塑封料行业产量
图表：2012-2019年4季度中国环氧塑封料行业需求量
图表：2016-2022年中国环氧塑封料行业市场规模预测
图表：2019年汉高华威电子有限公司环氧塑封料产量对比
图表：2019年长兴电子材料(昆山)有限公司环氧塑封料产量对比
图表：2019年南通住友电木有限公司环氧塑封料产量对比
图表：2019年日立化成工业（苏州）有限公司环氧塑封料产量对比
图表：2019年北京科化新材料科技有限公司环氧塑封料产量对比
更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202105/220964.html>